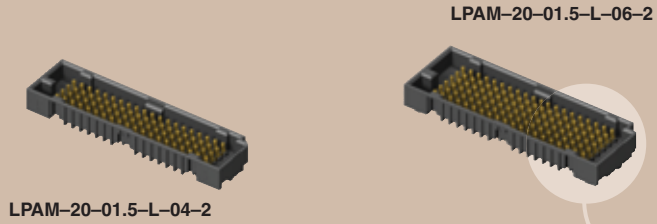


(1,27mm) .050"

LPAM 系列



高速薄型开放式连接器

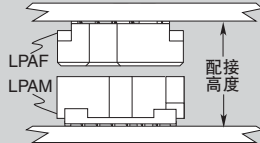
技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?LPAM

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物
端子材料:
铜合金
电镀:
在 50μ" (1.27μm) 镍上镀金或锡
触点电阻:
测试中!
额定电流:
测试中!
性能:
测试中!
工作电压:
测试中!
符合 RoHS 规范要求:
是可无铅焊接:
是

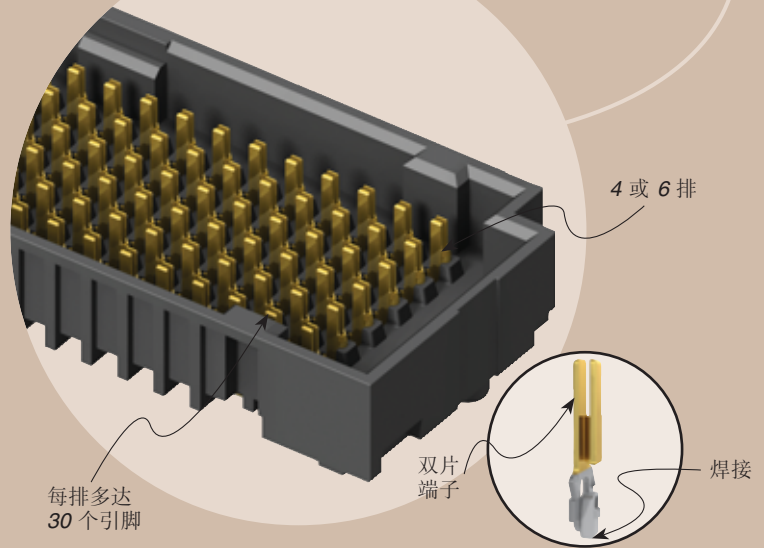
配件:
LPAF

配接高度



配接高度*	
LPAM 引线式样	LPAM 引线式样
	-03.0 -03.5
-01.0	(4,00) .157 (4,50) .177
-01.5	(4,50) .177 (5,00) .197

*加工条件将影响配接高度。

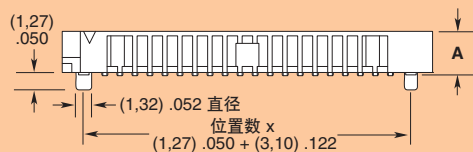
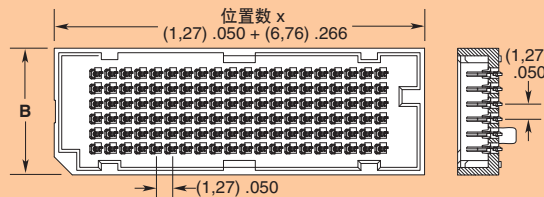


还提供

- 锡铅焊接。
 - 其他引脚/排和排数。
 - 其他镀金选项。
- 请致电 Samtec。

LPAM	每排引脚数	引线式样	电镀选项	排数	2	选项	TR
	-10, -20, -30 (每排)	-01.0 = (1.0mm) .039" -01.5 = (1.5mm) .060"	-L = 触点区域镀 10μ" (0.25μm) 的金, 焊尾上镀雾锡	-04 = 四排 -06 = 六排	-2 = 无铅锡合金 95.5% 锡/3.8% 银/0.7% 铜 焊接	-K = 聚酰亚胺膜 取放垫	-TR = 卷带 封装

排数	B
-04	(8,18) .322
-06	(10,72) .422



引线式样	A
-01.0	(3,68) .145
-01.5	(4,19) .165

注: 某些尺寸、式样和选项为非标准型, 不可退换。